

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-14

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（反路演活动）
参与单位名称及人员姓名	中邮证券、财通资管、浦银安盛、富国基金
时间	2025 年 8 月 12 日
地点	/
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理、董事会秘书（暂代）：胡黎强
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2025 年半年度业绩情况 2025 年半年度，公司实现销售收入 7.31 亿元，较上年同期减少 0.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,576.20 万元,较上年同期增加 4,626.96 万元,同比上升 151.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,256.39 万元,较上年同期增加 3,039.92 万元，同比上升 170.44%。 本报告期公司实现主营产品综合毛利率 39.60%，较上年同期提升 4.18 个百分点。 截至 2025 年 6 月 30 日，受报告期内收购控股子公司南京凌鸥创芯电子有限公司剩余少数股东权益及实施利润分配的影响，公司实现归属于上市公司股东的净资产 11.47 亿元，比上年期末减少 8.88%。 二、问答环节 1、公司高性能计算电源芯片业务收入今年上半年同

	比增长 419.81%的主要原因是什么？该产品线的业务进展和客户拓展情况如何？ 答：公司高性能计算产品线的数字多相控制器、DrMOS、POL 及 Efuse 全系列产品已经实现量产，进入规模销售阶段，特别是新一代显卡应用，多家海外和国内客户开始大批量出货，带动整条产品线业务增长，依托于 DrMos 产品适应市场需求革新突破，高性能计算电源芯片业务得以快速增长，更多国际、国内客户实现业务破局。公司通过持续的 BCD 工艺和产品创新使得第二代 DrMos 芯片性能显著提升，成本明显下降，市场竞争力增强，已获得多家客户导入，并进入量产阶段。 2、公司工艺和技术研发进展怎么样了？ 答：报告期内，公司对高压 BCD-700V 工艺平台进行了技术升级，第六代高压工艺平台已经开始量产，该工艺可覆盖 LED 照明驱动、AC/DC 电源和部分电机控制驱动芯片产品，进一步巩固了晶丰明源在高压工艺技术和产品上的领先优势。 低压 BCD 工艺平台方面，公司自研的第一代 40V BCD 工艺平台高性能计算电源芯片已大批量稳定量产，基于自研第二代 40V BCD 工艺平台设计的 DrMos 产品性价比显著提升，已进入批量生产。目前公司正在推进第三代 40V BCD 工艺的研发，基于该工艺平台的芯片设计已经完成，等待生产验证，预计在 2026 年可实现量产。 封装技术方面，公司独占封装 EHSOP12 已进入量产阶段，EMSOP 封装技术也在持续研发中，预计将进一步带动成本下降。 3、上半年综合毛利率同比提升有什么具体原因吗？ 答：一方面归功于公司积极契合市场需求，通过工艺迭代、加强供应链管理等方式持续降本增效，使得整体毛
--	--

	利率较上年有所增长；另一方面，公司不断优化产品结构，进一步增强在电机控制驱动芯片领域的技术及产品能力，电机控制驱动芯片收入占比进一步提升，收入较上年同期增加 24.30%；同时，依托于 DrMos 产品适应市场需求革新突破，高性能计算电源芯片业务得以快速增长，收入同比上升 419.81%。 4、电机控制驱动芯片业务进展如何？ 答：今年上半年，公司使用自有资金收购了凌鸥创芯剩余 19.19%的股权，本次收购完成后，凌鸥创芯成为公司的全资子公司。报告期内，电机控制驱动芯片实现销售收入 1.92 亿元，较上年同期增长 24.30%。公司通过技术创新持续提升产品集成度和性能，推动业务高速发展。报告期内，汽车电子业务继续实现突破，推出了超高集成度的 ALL-in-One 智能车规级 MCU，空调出风口产品实现超百万颗销量外，热管理及座椅通风均有产品进入量产。 5、LED 照明业务收入下降较多是什么原因？ 答：LED 照明驱动芯片销售收入较上年同期下降了 15.02%，主要是因为通用 LED 市场竞争激烈，使得公司产品的销量与销售单价都出现明显下滑。但另一方面，公司通过扩大智能 LED 照明产品的市场布局，在可控硅调光业务及高性能灯具业务上保持领先地位，同时实现北美 0-10V 调光大功率照明产品、DALI 调光业务的显著增长；另外第六代高压 BCD-700V 工艺平台及独占创新封装 EHSOP12 逐步量产，叠加供应链整合成效，整体产品单位成本下降 14.17%，毛利率提升 4.46 个百分点。 6、公司收购易冲科技的进展如何？ 答：本次重组工作仍在积极推进中。今年 7 月，公司收到上交所出具的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的
--	--

	审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”），要求公司回复审核问询的时间总计不得超过 1 个月。如难以在前述时间内回复的，可按相关规定向上交所申请延期一次，时间不得超过 1 个月。 2025 年 8 月 2 日，公司于上交所网站披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于延期回复〈关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的公告》，鉴于《审核问询函》涉及的部分事项还需进一步落实，公司无法在 1 个月内向上交所提交完整的书面回复及相关文件。为切实稳妥做好《审核问询函》回复等相关工作，经与本次交易的各方及中介机构审慎协商，公司向上交所提交延期回复的书面申请，申请自《审核问询函》回复届满之日起预计延期不超过 1 个月提交问询回复等相关文件并及时履行信息披露义务。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和同意注册的时间均存在不确定性。公司会严格按照相关法律法规履行信息披露义务，具体进展请关注公司后续公告。
附件清单（如有）	/
日期	2025 年 8 月 12 日